

〈編集後記〉

前号 (No. 556) からの続編をお届けします。今号は前工程 (ウエハー加工工程) の外部化について論じています。ここでは、ウエハー上の回路の線幅の単位が微細なミクロンからさらにその 1000 分の 1 (10 億分の 1 メートル) であるナノへと技術が進化するとともに、その設備コストもいっそう増大することが述べられています。

こうした環境の下で、新たな戦略として登場したのが、工場を持たないファブレス企業 (シリコンウエハー製造の 75% 以上を外部委託) であり、これに対応して、製造を専門に受託する会社であるファウンドリーが台湾を中心とする東アジアに誕生します。この「垂直非統合」モデルが 21 世紀に入ってめざましく広がります。

そして、この対極には、75% 以上を自製する垂直統合型デバイスメーカー (IDM) が存在しますが、これらの IDM にもファブレス化の過程がみられ、いくつかの事例研究でその過程の進行について検討しています。

IT 産業の今後いっそうのグローバル展開の動向が注視されるところです。 (T.F.)

神奈川県川崎市多摩区東三田 2 丁目 1 番 1 号 電話 (044)911-1089

専修大学社会科学研究所

(発行者) 町田俊彦

製作 佐藤印刷株式会社

東京都渋谷区神宮前 2-10-2 電話 (03)3404-2561
